

证券代码：688020

证券简称：方邦股份

广州方邦电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>网络线上会议交流</u>
参与单位名称及参与人姓名	财通证券、天风证券、海通国际、山西证券、国泰君安证券
时间	2024年7月31日、8月1日
地点	网络线上会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：王作凯
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、对今年电磁屏蔽膜业务有何展望？</p> <p>根据信通院、IDC 等市场相关第三方机构发布的数据，今年上半年国内、全球手机出货情况持续回暖，叠加公司成功取得相关头部手机终端最新旗舰机型的屏蔽膜主供应商资格，我们预计公司屏蔽膜业务今年将实现较好增长。与此同时，公司密切关注新客户、新领域的技术发展趋势，如柔性屏蔽罩、折叠屏手机要求电磁屏蔽膜更薄、更耐弯折，AI 手机的高算力性能引发手机内部明显的散热问题，要求电磁屏蔽膜在屏蔽功能的基础上承担部分散热功能等，持续迭代升级产品性能，以新产品、新解决方案缩短客户“等待期”，争取实现增量突破。</p>

二、请介绍公司相关新产品的进展情况。

关于带载体可剥离超薄铜箔，从去年三季度至今，陆续通过相关载板厂及终端认证，持续获得小批量订单；预计今年三季度通过相关下游的量产认证和审厂工作，推动订单进一步上量；

关于挠性覆铜板，坚定推进原材料自研自产战略，使用自产铜箔生产的 FCCL 产品在今年上半年已实现一定规模销售，产品在中小规模软板厂商逐步铺开，产品制程数据和市场履历不断积累，预计今年下半年实现订单加快上量，争取全年实现销售量 20-30 万平方米，逐步成为公司业绩新增长极；使用自产铜箔+自产 PI/TPI 生产的 FCCL，下游测试认证工作正有序开展。

关于薄膜电阻，已持续实现小批量订单；下半年将进一步加快认证进度，推进通过更多下游认证，逐步实现量产突破，增厚公司业绩；同时密切关注电子产品芯片热管理的前沿需求，加大热敏型薄膜电阻的开发及下游认证工作。

与此同时，公司根据相关头部消费电子终端的最新技术需求，利用自身的可剥铜、类 ABF 树脂材料以及合成技术，正在进行 RCC、FRCC、超薄介电层 FCCL 等相关前沿产品的开发和下游测试认证工作。

三、根据市场信息，英伟达（NVIDIA）最新 AI 服务器将采用高速铜缆连接方案，该方案存在电磁屏蔽的需求，请问公司对这方面的市场预估以及相关布局、最新进展。

高速铜缆屏蔽材料的需求，主要取决于英伟达最新 AI 服务器的出货量，根据相关研报，其出货量将从今年的数千台增长至明年的数万台，由此预估应将带来高速铜缆屏蔽材料

	<p>的较大市场空间。在这方面，我们和英伟达及其上游国内外线缆供应商进行了密切对接和沟通，根据其技术要求进行了相关铜箔产品的开发并进行了送样，经客户测试，产品性能符合要求，关键指标优于竞品。目前在进行产品性能的进一步优化及相关商务洽谈工作。</p> <p style="text-align: center;">四、公司对后续的整体业绩如何展望？</p> <p>随着消费电子市场的逐步回暖以及相关产品认证工作稳步推进，我们预计屏蔽膜、可剥铜、FCCL、薄膜电阻等产品将在后续实现逐步的业绩增量；对于铜箔业务，公司将持续提升良率，并根据市场情况动态调整优化产品结构；同时将大力推进高速铜缆用屏蔽铜箔项目，紧跟终端客户明年及后续出货的大幅增长节奏，逐步争取更多市场份额。通过以上举措，预计公司后续整体业绩有望逐步向好。</p> <p>以上预测具有不确定性，不构成投资承诺，敬请理性决策、注意投资风险。</p>
附件清单（如有）	